

股票代號 7828



創新服務(股)公司 興櫃前法人說明會

May 2025

主辦券商:凱基證券



免責聲明

股票代號 **7828**

- 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。創新服務股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

目錄

1. 公司簡介
2. 產業概況與產品項目
3. 營運策略及未來展望
4. Q&A

1. 公司簡介

創新服務為您的創新，提供最專業的服務

公司簡介

股票代號 7828



- 創新服務成立於 2004 年
- 資本額：新台幣 3.63 億元
- 員工數：98 人
- 服務據點
 - 新竹
 - 台中廠
 - 高雄辦公室
- 營業項目
 - 半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
 - 先進封裝解決方案。



董事會成員

股票代號 7828

職稱	姓名	經歷
董事長	吳智孟	畢業於國立中央大學機械所碩士 中強光電(股)公司研發部處長、天瀚科技(股)公司研發部處長、揚明光學(股)公司研發部處長
董事	Technoprobe S.p.A. 代表人：HELLEN KEE	畢業於都柏林大學市場行銷 (榮譽) 學士 Technoprobe Taiwan Co., LTD. 亞太區業務副總、Technoprobe Taiwan Co., LTD. 台灣總經理
董事	力晶創新投資控股(股)公司 代表人：謝明霖	畢業於國立臺灣大學商學研究所碩士 力晶創新投資控股(股)公司總經理、力晶科技(股)公司總經理特別助理、力晶科技(股)公司副總經理、力晶積成電子製造(股)公司副總經理
董事	銳邑科技(股)公司 代表人：黃俊祥	畢業於萬能科技大學計算機系學士 銳邑科技(股)公司-董事長暨總經理
董事	佶元投資(股)公司 代表人：溫士昆	畢業於國立台灣科技大學機械系畢業 敬東科技(股)公司董事長、躍昌科技(股)公司董事長、昆山群岱精密機械有限公司董事長、富啟投資有限公司董事長、佶元投資(股)公司董事長
董事	展成技研有限公司 代表人：鄭添乾	畢業於國立台灣大學電機系碩士 創捷科技(股)公司總經理、展成技研有限公司董事長、展育科技(股)公司董事長、威杰科技有限公司董事長
監察人	陳素美	畢業於南安普頓大學財務會計碩士 盟智科技(股)公司財務處長
監察人	丘于川	畢業於淡江大學機械系學士 創新服務(股)公司創辦人、海德漢(股)公司 技術服務經理

經營團隊

股票代號 7828

1

吳智孟 董事長/總經理

國立中央大學機械所碩士
中強光電(股)公司研發部處長
天瀚科技(股)公司研發部處長
揚明光學(股)公司研發部處長
相關產業27年經歷

3

張簡毅仁 研發副總經理

國立澳洲大學資訊科技所
旭聯科技(股)公司-軟體開發部專案經理
智崴資訊科技股份有限公司多媒體事業
處資深工程師
相關產業經歷21年

5

廖健評 總經理特別助理

國立台灣大學機械研究所碩士
南通萬德觸控面板科技有限公司總經理
士耀國際(股)公司總經理室特助
韶陽科技(股)公司總經理室特助
相關產業經驗24年

2

林俊忠 業務副總經理

國立中山大學公共事務管理研究所碩士
點晶科技(股)公司總經理室特助
點晶科技(股)公司軸心事業處處長
點晶科技(股)公司軸心事業處副處長
點晶科技(股)公司軸心事業處專案經理
相關產業經歷24年

4

伍建仲 財務副總經理

中原大學會計系學士
資誠聯合會計師事務所審計部協理
瀚薪科技(股)公司財會處長
相關產業經歷27年

6

吳政忠 總經理特別助理

萬能工商專校電子工程系
富智康國際(股)公司項目管理部技術處長
連營科技(股)公司-系統開發部主任
相關產業25年經歷

公司里程碑

- 公司成立
- 推出第一代塑膠剪切機。
- 開啟光學產業自動化革命

- 取得半導體晶圓國際大廠
MEMS探針植針代工業務，
已累積超過3億根針經驗。

- 高密度銅柱端子模組，
應用於WIFI模組大量送
樣。

- 高密度銅柱端子模組，應用於
Power Module, TGV, PLP模
組大量送樣。

2004

2014

2016

2022

2024

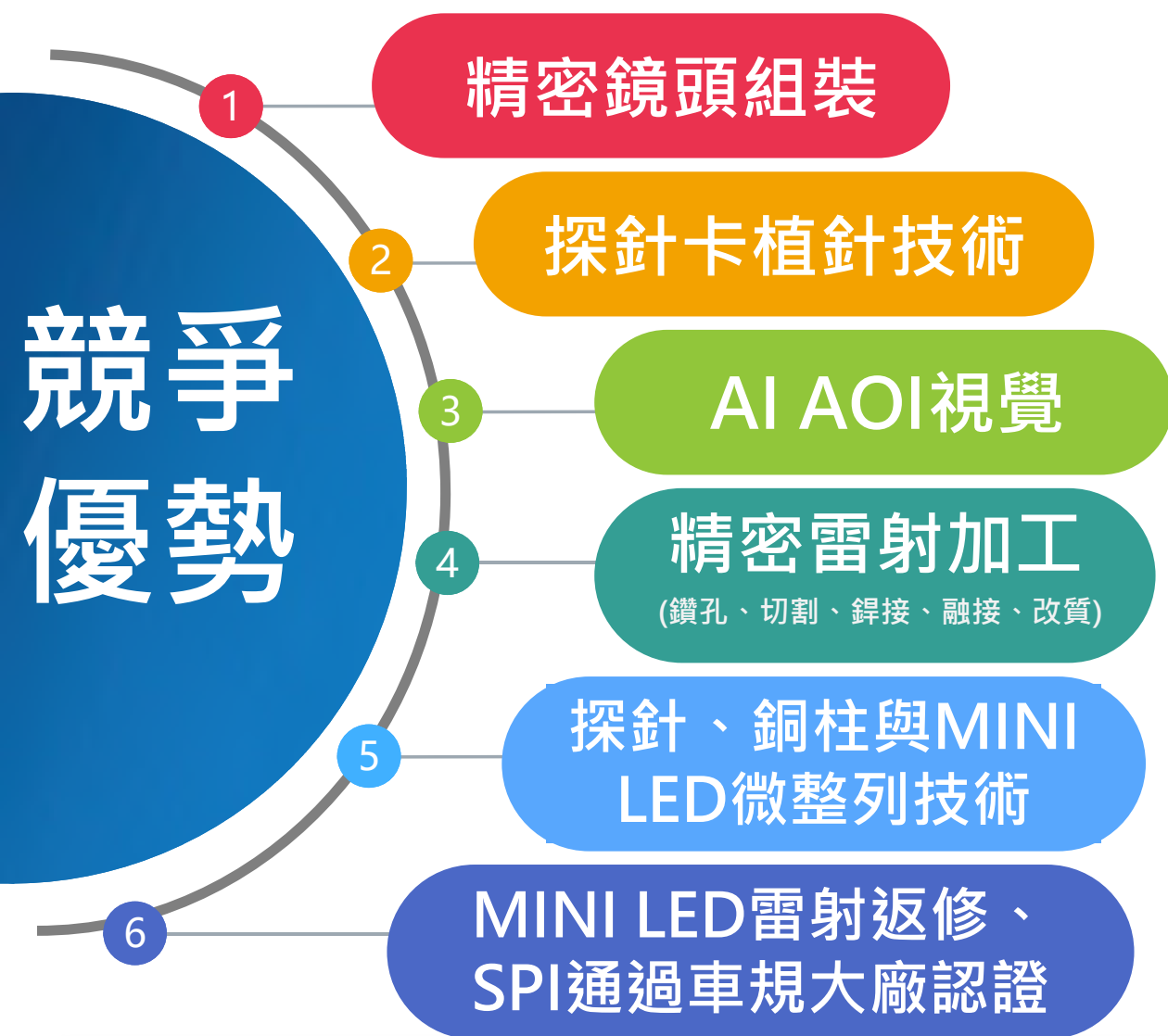
2025

- 切入半導體先進測試製程，開發
半導體晶圓級測試MEMS探針
卡自動植針設備
- 開啟探針卡植針自動化革命

- 自動化植針設備獲得
主要探針卡大廠採用

- 探針卡廠大量採用植針
設備。

- TP成為策略投資人
- 推出MEMS探針卡Probe
Card整體自動化維修解決方案



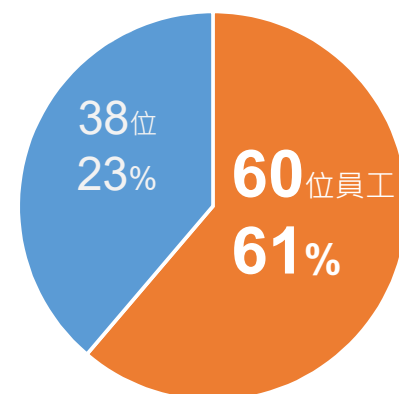
為半導體及光電Tier 1大廠
的創新技術與先進製程，
提供專業的客製化設備。

專利

股票代號 7828

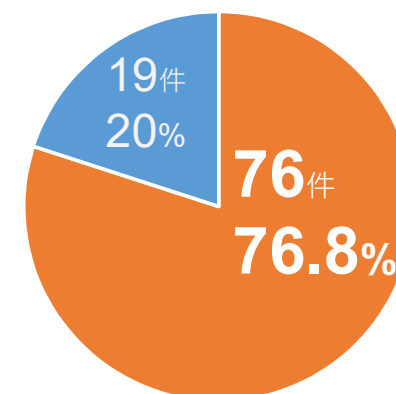
專利項目	已取得		審查中	
	發明	新型	發明	新型
半導體先進製程設備	13	1	2	0
先進封裝設備	10	5	23	3
其他	15	8	13	2
小計	38	14	38	5
合計	52		43	

研發人員佔比61%



■ 研發人員 ■ 其他人員

專利



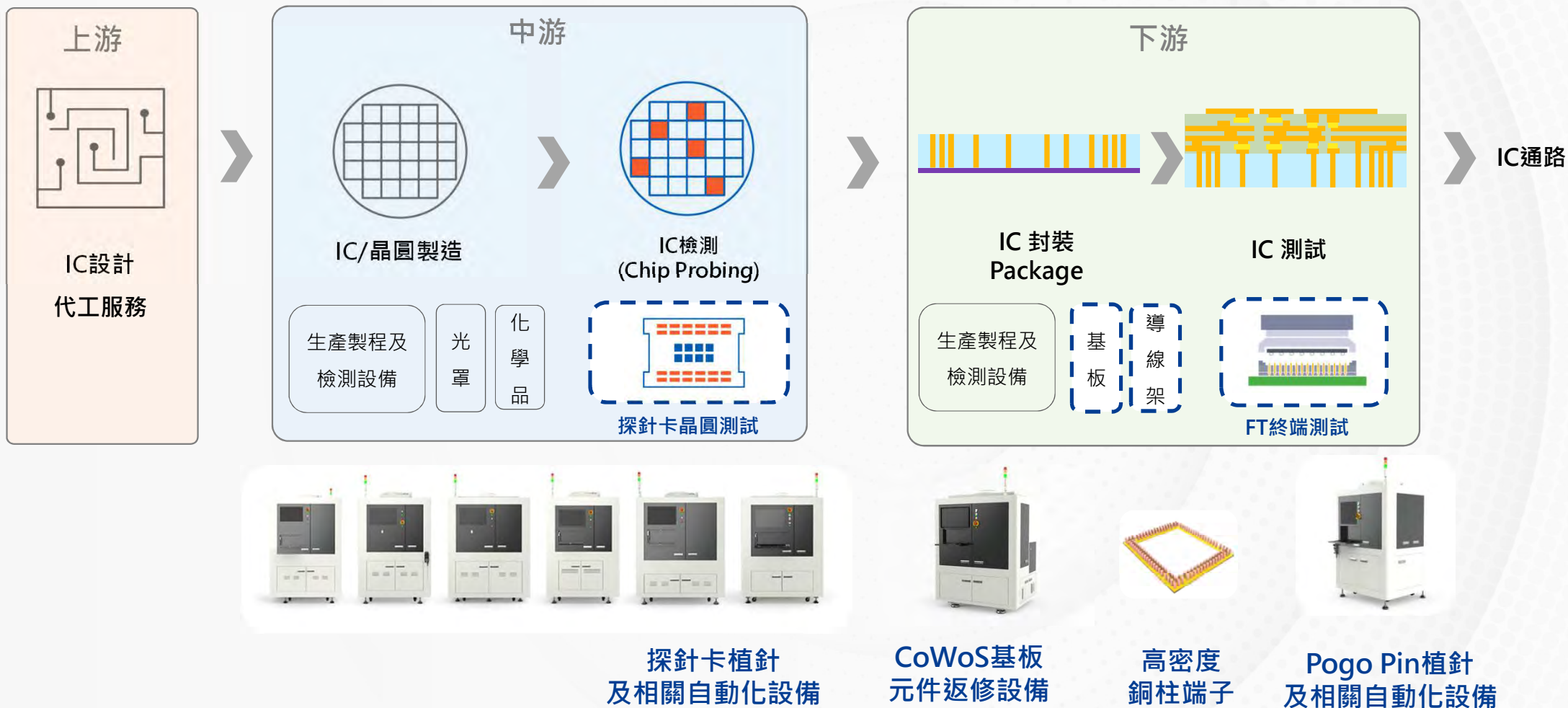
■ 發明 ■ 新型 *

截至目前為止，本公司已取得52件專利(發明38件、新型14件)，另有43件專利申請中(發明38件、新型5件)。

2. 產業概況 & 產品項目

市場定位

股票代號 7828



產品

探針卡 整體解決方案

- MEMS探針卡自動植針機
- 五軸雷射鑽孔機
- 雷射塑針設備
- MEMS探針卡維修線
- CoWoS FT自動化植針(90um)、檢測機



MEMS探針卡維修線

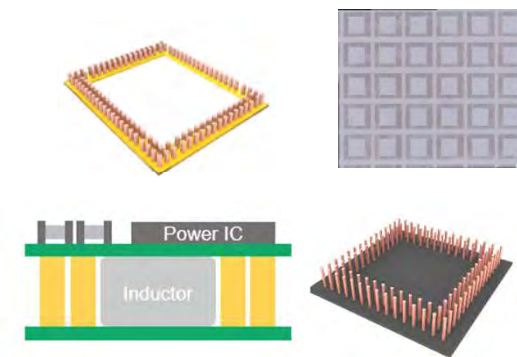
半導體 精密加工

- 精密雷射切割設備
- Mini LED自動化檢測與雷射返修設備
- 精密雷射除膠機
- MEMS Mirror自動化精密組裝設備
- CoWoS基板元件返修設備



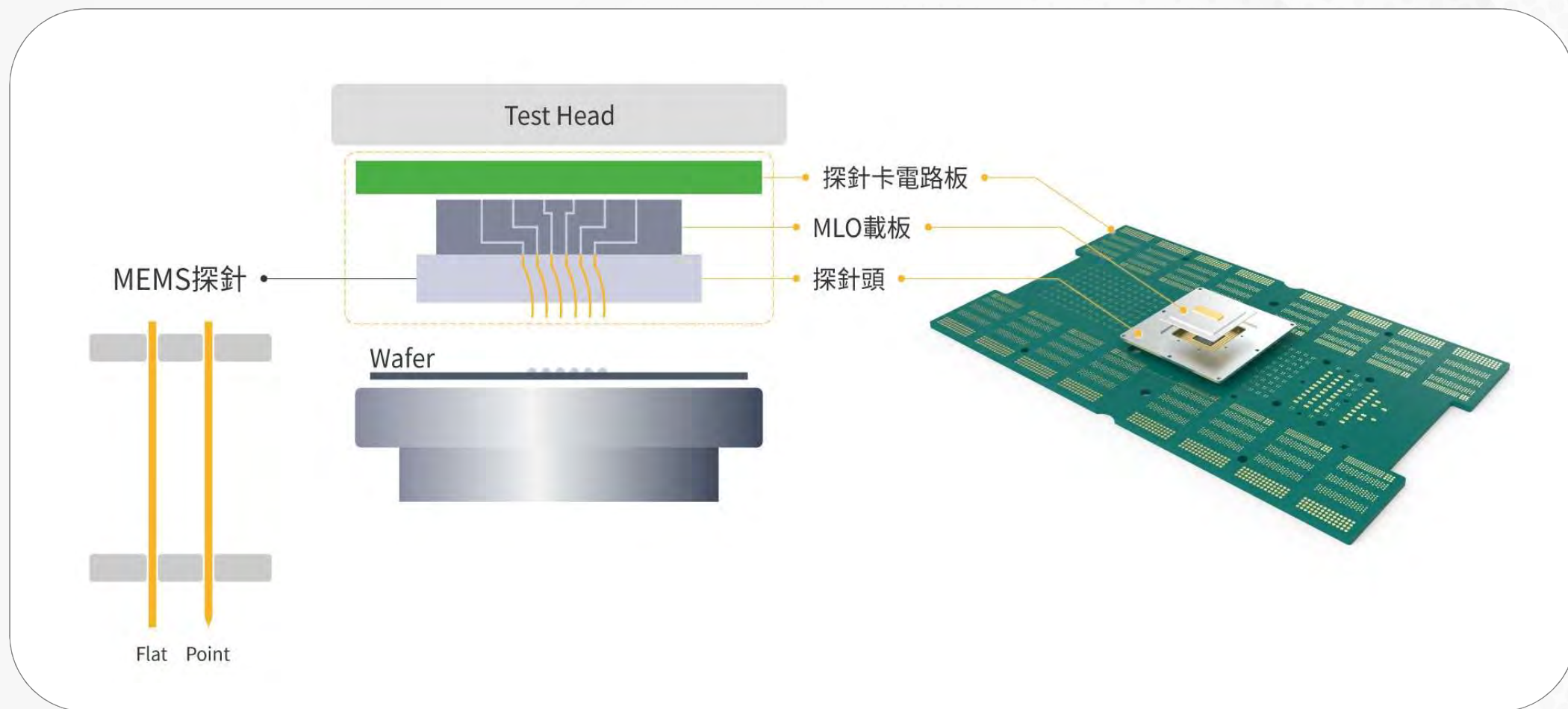
先進 封裝

- WIFI Module高密度銅柱端子
- Power Module高密度銅柱端子
- Interposer (10:1)銅柱TGV



探針卡示意圖

股票代號 7828



探針卡市場

● 市場規模與成長*

- 2025年全球探針卡市場預估達 33億美元
- YoY +23.6% 2024-2029年CAGR 10.7%
- 截至2024年，MEMS探針卡佔據全球探針卡市場**71.6%**，但自動化比例低，**自動化方案具大幅成長空間**。

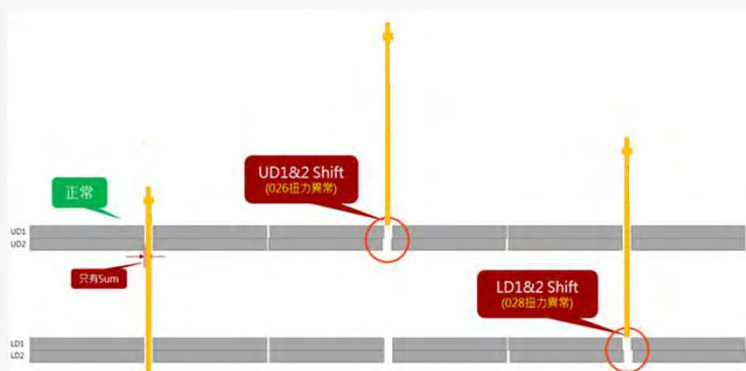
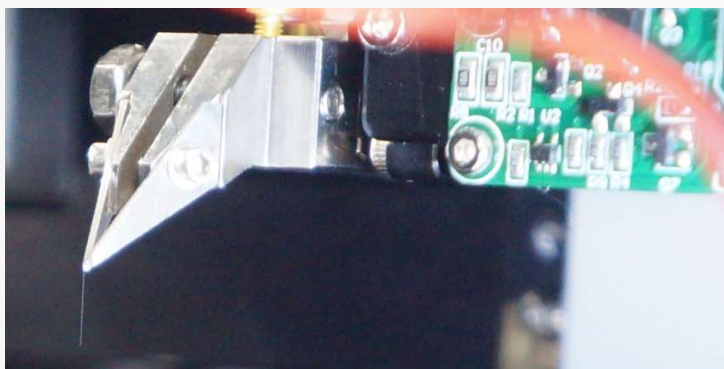
● 技術趨勢/成長動能

- 2025年MEMS探針卡Pin count數150,000pin以上，故dual arm 植針機成長動能大增。
- 針對AI尖頭探針如何磨尖的需求大增。
- 探針卡維修的L/T因應客戶要求，自2個月下降至2-3週。
- 新投入Probe card廠商眾多，植針機已成為必要設備。

**台積電於2025年第一季法說會中公布財報，營收8,392.5億元、年增41.6%，EPS為13.94元，財報全面優於市場預期。值得關注的是，先進製程（7奈米及更先進）貢獻營收比重高達73%，其中3奈米與5奈米製程合計即貢獻58%，顯示先進製程產能持續擴張與放量。此外，AI晶片強勁需求為主要動能來源，高效能運算（HPC）應用貢獻比重達59%，遠高於智慧型手機（28%）與其他應用。這進一步推升了高密度、高精度晶圓測試的需求，直接帶動探針卡市場規模快速成長。

自動化植針設備

股票代號 7828

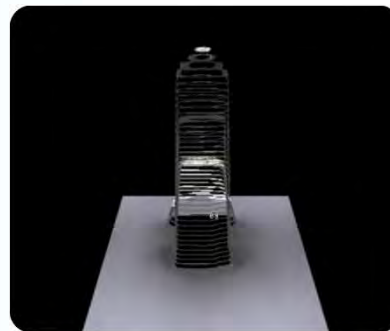
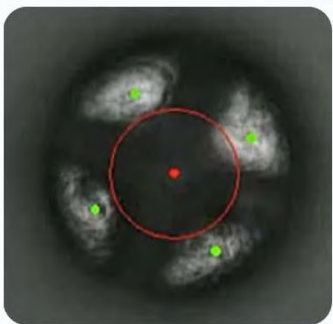


以High Pin count探
針卡 150,000pin/片，
推算產出L/T

	人工	單Arm 植針機	雙Arm 植針機
探針卡產出L/T*	83天	30天	15天
日產能	600pin/人	5000pin/天	10000pin/天
稼動時間	3班*8hr	24hr/天	24hr/天
來料IQC	無	有	有
植針過程PQC	無	有	有
植針過程PQC	無	有	有
植針結果OQC	無	有	有
品質壽命	不穩	優	優

飛秒雷射塑針機

股票代號 7828

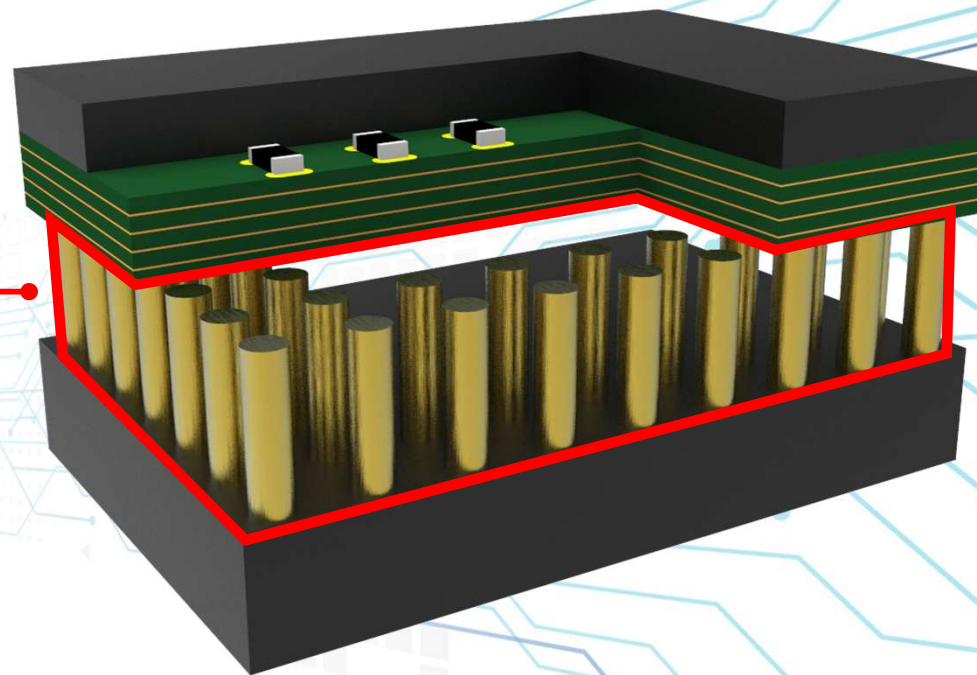
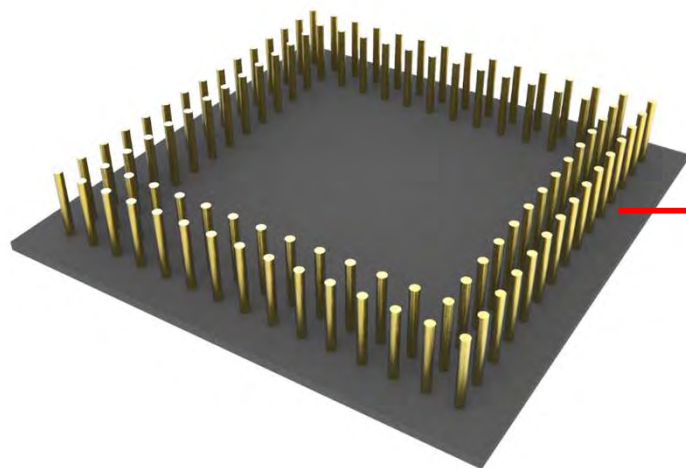


可直接在Probe Card上對針尖整形



高密度端子模組

股票代號 7828

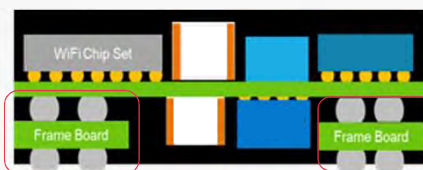


- 應用市場

- WiFi Module
- Power Module

先進封裝 – Pin-Out導通技術演進

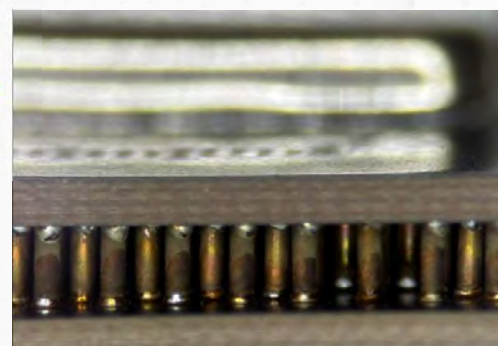
股票代號 7828



Frame Board



Cu-Pillar



- Fine Pitch
- Higher I/O
- Flexible Design Architecture
- Electrical
- Thermal
- Mechanical

WiFi Module市場

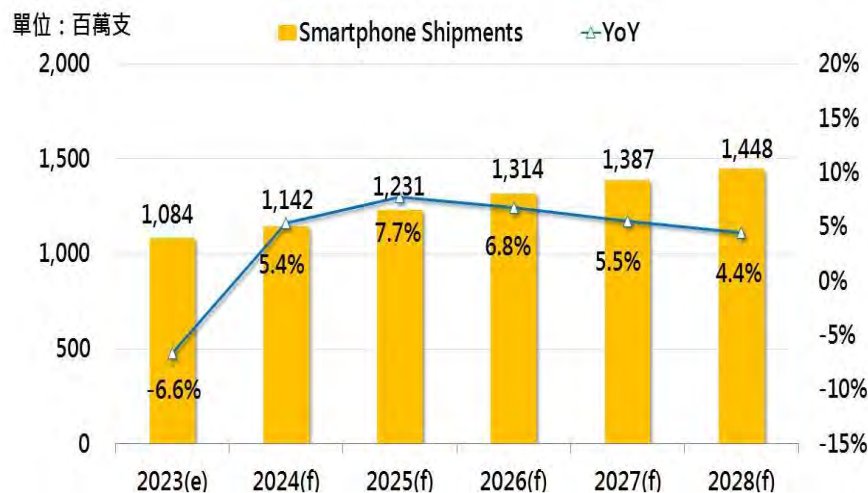
股票代號 7828

● 市場規模與成長

- 2024 - 2028全球智慧型手機出貨量，預計每年將成長 4% 至 8%。
- 在 蘋果 iPhone 16 導入 AI 及 WiFi 7 功能後，預計未來各品牌廠商將積極擴大其 AI DeepSeek, 大語言模型及 WiFi 7 應用於手機產品線。
- 預估 2025 年，AI 手機的市場滲透率將達到 25%，全球出貨量將達到 3.03 億支；2028 AI 手機的滲透率預計將突破六成，全球出貨量將達到 8.69 億支。
- AI DeepSeek, 大語言模型 及WiFi 7 模組預計也將大幅應用於耳機、手錶及各式家電裝置。

● 技術趨勢/成長動能

- WiFi 7模組封裝為取得更佳散熱、電訊號及更微型化封裝，將逐漸採用銅柱取代錫球Frame Board。
- 2024年起國際手機廠導入使用WiFi模組銅柱封裝，預計2026 Q4量產。



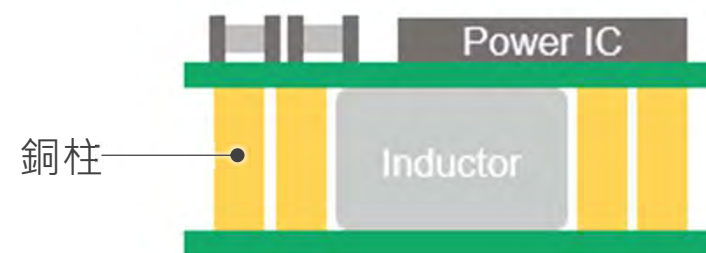
資料來源: DIGITIMES Research, 2023/10



垂直供電模組(VPD)模組:

車用及AI Data Center應用

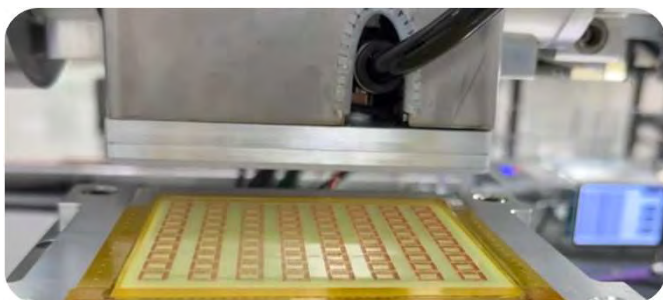
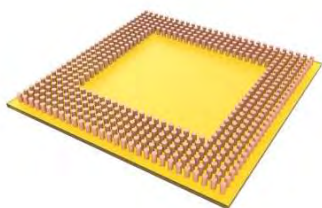
- 如右圖所示立體結構封裝，中間包附大體積電感，高度超過5mm，電流超過100A，銅柱模組為最佳方案。
- 高深寬比(10:1)整合電感、電源管理晶片等垂直銅柱導通整合電源模組
- 已獲多家模組大廠導入，預計2026年底量產



先進封裝高密度銅柱端子

股票代號 7828

成品 示意圖



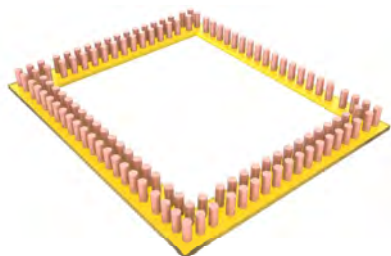
30000pin/片

高密度銅柱端子適用於先進封裝有機載板、玻璃基板以及晶圓級先進封裝製程，應用於高深寬比、高導電、高散熱、異質整合封裝、功率模組封裝等銅柱導通連結應用。

客製化高密度端子銅柱模組

股票代號 7828

成品 示意圖



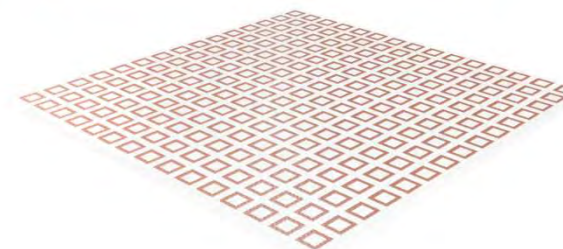
Tray



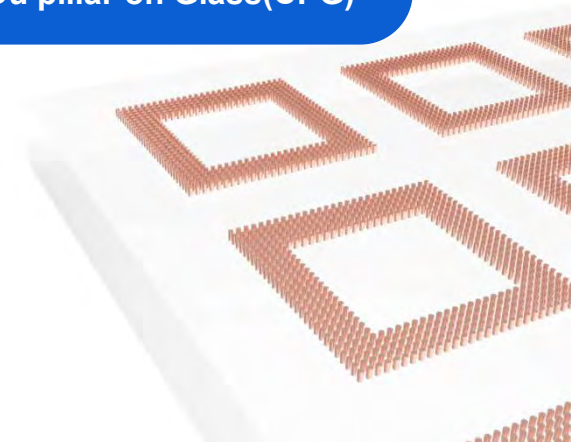
Tape & Reel



TGV

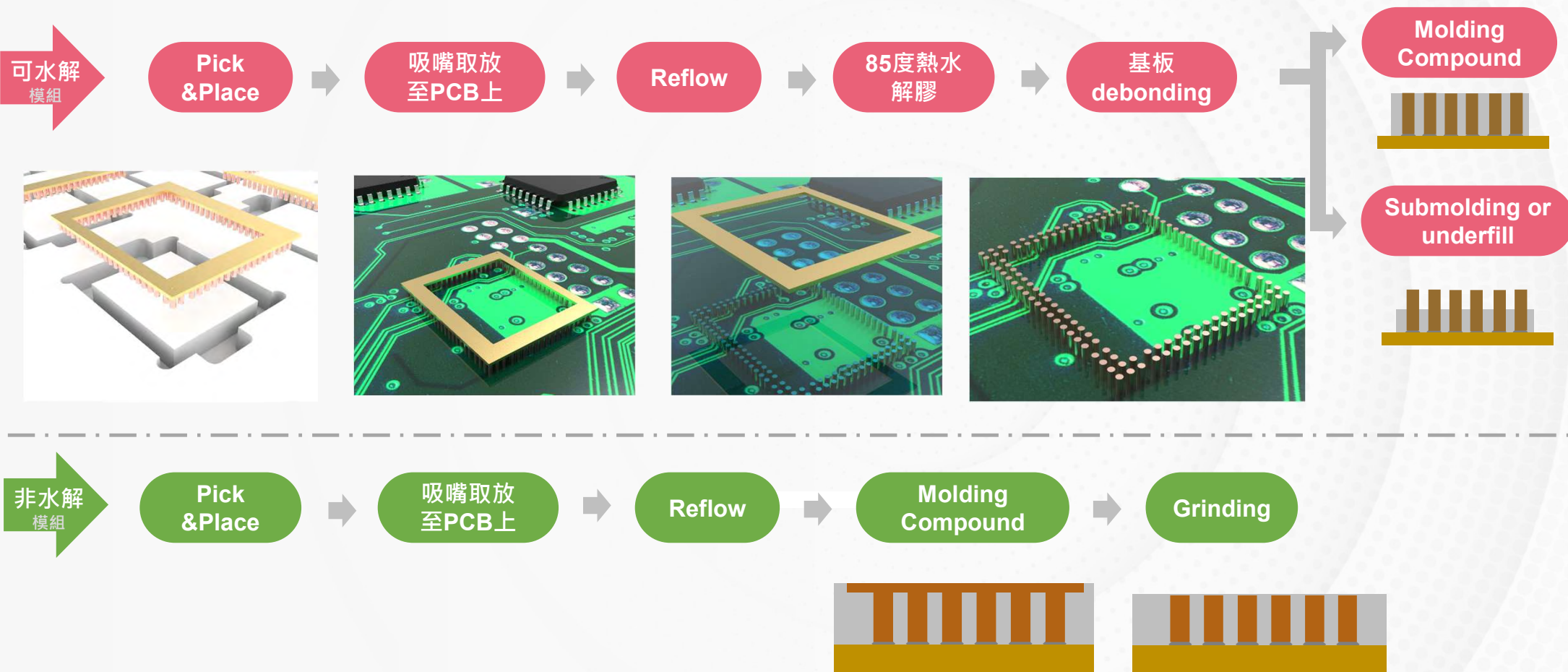


Cu pillar on Glass(CPG)



銅柱Lead Frame模組 移轉流程

股票代號 7828



3. 營運策略及未來展望

營運策略

股票代號 7828

1 持續開發探針卡生產、檢測、維修相關設備

- 從單ARM植針機->雙ARM植針機。
- 針對尖頭針開發精密雷射修針機。
- 開發探針卡維修自動化相關設備，縮短維修時程，提升競爭力。

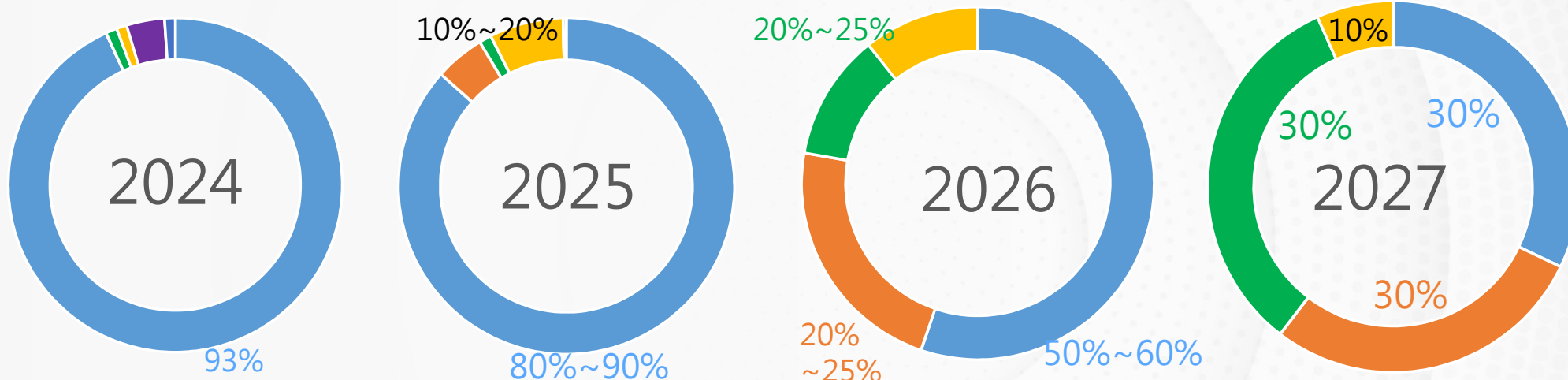
2 代理TP探針卡材料包探針卡維修代工

- 從設備與代工廠，進階為探針卡材料包供應商。
- 建置探針卡維修產線，提供探針維修代工，縮短傳統探針卡維修週期。

3 將銅柱巨轉導入先進封裝製程

- 提供創新銅柱方案，專注Power 模組及 TGV、CoWoS 封裝等市場
- 從設備廠進階為銅柱模組供應商，進一步改善營收波動體質。

三大營收主軸變化預估



■ 設備收入 ■ 產品收入-探針卡材料包 ■ 產品收入-銅柱巨轉 ■ 代工收入-ProbeCard維修

4. Q & A